

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2019年8月16日投资者关系活动记录表

编号：2019-08-001

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称 及人员姓名	大成基金管理有限公司：陈星宇 宝盈基金管理有限公司：陈金伟 兴业基金管理有限公司：廖欢欢 金信基金管理有限公司：江磊 诚通基金管理有限公司：廖慧杰 长盛基金管理有限公司：孟棋 中邮基金：周彭 西部利得基金管理有限公司：吴伯珩 富荣基金管理有限公司：李延峥 湘财基金管理有限公司：刑毅哲 泓德基金管理有限公司：刘力思 诺安基金管理有限公司：丁云波 建信基金：孙晟 安信证券：蒋朝庆、杨臻 招商证券：张益敏 光大证券：刘凯

平安证券：徐勇
广发证券：黄宇
中信证券：郑泽科、胡叶倩雯
中信建设证券：王越
方正证券：宋辉
国元证券：杨钟
西南证券：熊翊宇
东兴证券：于文龙
财通证券：张苏
德邦证券：林烈雄
恒泰证券：马冠东
中国民生信托有限公司：王秀平
上海国泰君安证券资产管理有限公司：陈思靖
华夏未来资本管理有限公司：丁鑫
光大证券资产管理有限公司：王宇
华安财保资产管理有限责任公司：刘宇辙、孙楠
平安银行股份有限公司：黄毅东
仁桥（北京）资产管理有限公司：张鸿运
上海砥俊资产管理中心（有限合伙）：唐皓
泓铭资本金融控股有限公司：黄雪雨
上海中润投资有限公司：罗志强
上海朴易资产管理有限公司：宋伟
深圳沃伯格投资控股有限公司：郑奇国
广东竣弘投资管理有限责任公司：陈翔
深圳市前海鼎业投资发展有限公司：陈志雄
北京永瑞财富投资管理有限公司：何鲜玉
浙江中大集团投资有限公司：曲芳
中睿合银投资管理有限公司：陈诚、叶昊坤
上海鸿凯投资有限公司：王芹

	<p>清水源投资管理有限公司：程宇楠</p> <p>深圳裕晋投资公司：杨烽</p> <p>第一创业：陈晓波</p> <p>北京遵道资产管理有限公司：杨增飞</p> <p>广州广证恒生证券研究所有限公司：李峥嵘</p> <p>合众益晟投资公司：苏诗</p> <p>上海鹏山资产公司：朱晋</p> <p>奇点资产管理有限公司：秦志毅</p> <p>凯读投资：胡楠</p> <p>深圳市金友创智资产管理有限公司：史献涛</p>
时间	9:30-11:20
地点	深圳南山区深圳湾科技生态园 1 区 2 栋 A 座 8 楼会议室
上市公司接待 人员姓名	<p>副总经理、董事会秘书：蒋威</p> <p>证券事务代表：王渝</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p>一、公司上半年整体情况介绍</p> <p>答：2019 年上半年，半导体业务销售收入占公司总销售收入比例突破 20%，是未来业务发展的重点。增长动力一方面是子公司减亏实现盈利；另一方面推行的降本增效，提升经营质量，控制期间费用，经营成本下降，加强现金流的管理，提升造血能力，经营结果跟公司的预判基本一致。公司立足于 PCB 行业发展，战略明确，始终围绕样板、小批量板开展业务，不涉足大批量，因此收入增长幅度相对于量产企业而言较小。从行业目前看，PCB 总量需求有所下滑，比较确定的是通信（主要是 5G），通讯也是公司最大的应用下游领域，其他领域表现会淡一些。</p> <p>二、与大基金合作进展情况</p> <p>目前双方还在沟通中，会成立专门的项目公司，独立运营。公司现有的 IC 封装基板业务不会放入项目公司。</p> <p>三、PCB 业务经营情况</p> <p>从毛利率方面看，贸易业务这块比较低，自身会高一些。单价高于</p>

同行。自身产能没有量产企业大，因此规模效应没有量产企业明显，小批量产能是有提升，但未来不会有大的产能扩充。2019年上半年，从PCB行业的阶段性趋势来看，自2018年第四季度开始PCB市场需求有所下降，并延续至了2019年第一季度和第二季度，公司PCB业务上半年订单获取有所下滑，今年8月份开始有所好转，但是力度比往年要弱，未来主要是通讯领域，光通讯景气度也不错，但工艺难度高，消费类电子，公司涉足较少，工控还处于去库存的过程。样板和小批量板的订单周期比量产企业要短。大的宏观经济环境不好，会受一定的影响；主观影响方面，公司PCB产线较多，工厂运营稍有波动，交付就会有影响。单一客户占比较低，不过分依赖单一客户、单一行业。目前来看，整体总量大幅增长阶段已过去，未来结构会分化，头部厂商会受益。最明确的是通讯领域，消费电子能否起来还需要再观察。

四、科学城二期工程新扩产能如何消化？

答：公司客户资源优质，与超过4,000家客户合作，多数为行业龙头或领军企业。现有客户的份额还可有进一步提升的空间，关键是自身要练内功，提升管理。规模和份额还会提升。深挖现有客户份额已足够。

五、降费措施

目前公司产品合格率提升，工艺技术指标保持稳定，存货有所下降；工厂管理环节，生产组织、材料单耗有所改善；经营性现金流指标提升，加强了回款，优化供应商货款结算方式。

六、IC封装基板业务情况

公司于2012年进入该领域，目标设定很明确，主攻存储领域方向，成为三星的供应商，目前存储类产品占比达到70%。从大的逻辑看，是进口替代，竞争目前还不存在，客户、产品会有阶段性的压力，市场格局是相对良性的。国内IC封装基板份额占全球比例不足3%，体量还能小，关键是自身能力的提升。IC封装基板是量产概念，属于标准化生产，自动化程度较高，但技术难度高，目前介入的上市公司不多，未来前景度比较好，但投资回报周期长，规模也大，门槛较高。客户以国内为主，

也有部分韩国和台湾客户。公司认为，战略意义大于经济意义，整体进展符合产业进展。应用领域包括 CPU、射频、存储、移动通讯等。近几年，IC 封装基板产能是没有扩产的，目前扩充的产能基本都在国内，价格跟产品结构、工艺技术难度有关。

七、贸易业务情况

公司的 PCB 贸易业务来自控股子公司 Fineline，毛利率低于公司，但其净利率比较稳定，属于轻资产，经营比较稳定。主要面向欧洲地区，上半年收入有所下滑，面临一定的压力，但利润不会有大的影响。

八、半导体测试板情况

行业前景不错，属于高附加值业务，同行业公司参与度不高，美国公司成本高，生产效率低于国内，去年公司全面介入管理，自去年下半年有明显改善。子公司上海泽丰，核心是工程团队的培养。

九、控股股东股权质押问题

今年 7 月解除了前期补充质押的 2,000 万股股份，目前质押率 85.83%。不存在平仓风险，风险可控。已有规划，会采取一些措施，让质押率进一步下降，但需要时间。

十、关于覆铜板的使用情况

部分会由客户指定，其他由公司根据客户订单情况自行采购。主要供应商为国内覆铜板生产厂商。

附件清单 (如有)	
日期	2019 年 8 月 16 日